УДК:621.315.592

### МЕХАНИЗМ ТОКОПЕРЕНОСА В ГЕТЕРОПЕРЕХОДАХ p-Cu,ZnSnS $_a/n$ -Si

#### А. Юсупов, К. Адамбаев, З. З. Тураев, С. Р. Алиев

Ташкентский автомобильно-дорожный институт, Ташкент, Узбекистан Поступила в редакцию 21.06.2016

Изучены электрические свойства анизотипных гетеропереходов p-Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>/n-Si, полученных сульфиризацией базовых металлических слоев, предварительно напыленных на кремниевую подложку. Обсуждаются вольт-амперные характеристики и установлены доминирующие механизмы токопереноса: при прямых напряжениях (3kT/e < V < 0.7 эВ) преобладают туннельно-рекомбинационные процессы с участием дефектных состояний на границе раздела гетероперехода, при увеличении напряжения (V > 0.8 В) доминирует туннельный механизм Ньюмена. Обратные токи через исследуемые гетеропереходы анализировались в рамках туннельного механизма токопереноса.

Ключевые слова: гетеропереходы, токоперенос, туннельный механизм.

### MEXAHI3M СТРУМОПЕРЕНЕСЕННЯ У ГЕТЕРОПЕРЕХОДАХ n-Cu ZnSnS /n-Si

# $\begin{array}{c} p\text{-}\mathrm{Cu_2ZnSnS_4/}n\text{-}\mathrm{Si} \\ \text{A. Юсупов, K. Адамбаєв, 3. 3. Тураєв, C. Р. Алієв} \end{array}$

Вивчено електричні властивості анізотипних гетеропереходів p-Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>/n-Si, отриманих сульфіризацією базових металевих шарів, попередньо нанесених на кремнієву підкладинку. Обговорюються вольт-амперні характеристики і встановлено домінуючі механізми струмоперенесення: при прямих напругах (3kT/e < V < 0.7 еВ) переважають тунельно-рекомбінаційні процеси за участю дефектних станів на межі поділу гетеропереходу, при збільшенні напруги (V > 0.8 В) домінує тунельний механізм Ньюмена. Зворотні струми через досліджені гетеропереходи аналізувалися в рамках тунельного механізму струмоперенесення.

Ключові слова: гетеропереходи, струмоперенесення, тунельний механізм.

## MECHANISM OF CURRENT TRANSPORT IN HETEROJUNCTIONS p-Cu,ZnSnS $_4/n$ -Si

### A. Yusupov, K. Adambaiev, Z. Z. Turaiev, S. R. Aliiev

Studied the electrical properties of heterojunctions anizo-type p-Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>/n-Si, received sulfurization base metal layers previously deposited on a silicon substrate. We discuss the current-voltage characteristics and established the dominant mechanism of current-voltage direct at (3kT/e < V < 0.7 eV) dominated tunnel-recombination processes involving defective conditions at the interface of heterojunction, increasing the voltage (V > 0.8 V). Newman dominated tunneling mechanism. Reverse current through the studied heterojunctions analyzed in the framework of current-tunneling mechanism. **Keywords:** heterojunction, current transfer, tunneling mechanism.

Интерес к четверному полупроводниковому соединению  $Cu_2ZnSnS_4$  (CZTS) связан с перспективой использования его в фотоэлектрических преобразователях (ФЭП) [1–3]. Компонентами CZTS являются распространенные, доступные, нетоксичные и дешевые элементы. Данное соединение обладает оптимальной шириной запрещенной зоны (1,5 эВ) [1] и высоким коэффициентом поглощения в видимой области (порядка  $10^5$  см<sup>-1</sup>) [2], что делает его перспективным для изготовления поглощающего слоя ФЭП. На основе гетероструктур CdS/Cu<sub>2</sub>ZnSnS(Se)<sub>4</sub>

получены солнечные элементы (СЭ) с эффективностью 12,6 % [3]. Однако, учитывая токсичность кадмия, в последнее время идет поиск материала заменяющего CdS в гетеропаре [4, 5].

При получении полупроводниковых гетероструктур очень важен выбор материала подложки. Для совмещения с другими компонентами полупроводниковой электроники требуются структуры на основе кремниевой подложки. У CZTS и Si хорошо совпадают параметры решеток [6]. Гетероструктуры  $Cu_2ZnSnS_4/Si$  являются

также перспективными для создания ФЭП в тонкопленочном исполнении [7]. Дальнейшее улучшение их параметров невозможно без понимания физических процессов, определяющих характеристики гетероперехода (ГП).

В данной работе исследуются электрические свойства анизотипных гетероструктур p-Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>/n-Si, полученных на подложке из монокристаллического Si.

Для создания ГП p-Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>/n-Si синтез слоев CZTS осуществлялся сульфиризацией базовых металлических слоев. На начальном этапе на кремниевой подложке методом вакуумного напыления были сформированы базовые слои компонентов — меди, цинка и олова в различной последовательности. Процесс проводился при вакууме порядка  $(3-5)\cdot 10^{-5}$  мм. рт. ст. На следующем этапе был произведен процесс сульфиризации металлических слоев из неограниченного источника. Процесс синтеза CZTS пленок описан в работе [8].

Стационарные вольт-амперные характеристики (BAX) полученных ГП были измерены при разных температурах. Омические контакты к структурам получены нанесением эвтектического состава сплава индий-галлий.

В общем случае прямой ток ГП состоит из надбаръерного, рекомбинационного в области пространственного заряда (ОПЗ) и туннельного токов [9]. Как следует из ВАХ ГП p-Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>/n-Si (рис. 1), величина напряжения, при котором наблюдается быстрый рост тока, уменьшается с увеличением

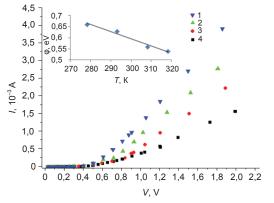


Рис. 1. Прямые ветви ВАХ гетероструктуры p-Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>/n-Si при разных температурах (1 — 318 K, 2 — 308 K, 3 — 293 K, 4 — 278 K). На вставке зависимость высоты потенциального барьера  $\phi$  от температуры

температуры, что свидетельствует об уменьшении высоты потенциального барьера при повышении температуры.

Высоту потенциального барьера  $\phi_k$ , соответствующую разным температурам, определяли путем экстраполяции линейных участков ВАХ. Температурная зависимость величины  $\phi_k(T)$  описывается следующим выражением:

$$\varphi_k(T) = \varphi_k(0) - \beta_{\omega} T, \tag{1}$$

где  $\beta_{\phi} = 3.2^*10^{-3} \, \mathrm{эB/K}$  — температурный коэффициент высоты потенциального барьера,  $\phi_k(0) = 1.55 \, \mathrm{эB}$  — значение высоты потенциального барьера ГП при абсолютном нуле температуры. Существенное различие значения  $\beta_{\phi}$  по сравнению с температурным коэффициентом ширины запрещенной зоны кремния ( $\beta_{\rm Eg} = 2.3 \cdot 10^{-4} \, \mathrm{эB/K}$ ), по-видимому, обусловлено поверхностными дефектами границы раздела ГП p-Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>/n-Si.

ВАХ ГП при приложении прямого напряжения в полулогарифмических координатах для различной температуры приведена на рис. 2. Из рисунка видно, что при напряжениях V > 3kT/e, ВАХ имеют прямолинейные участки, что свидетельствует об экспоненциальной зависимости

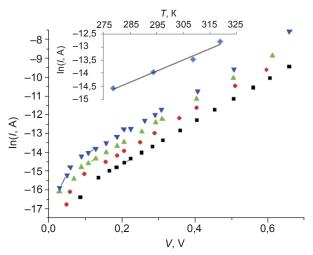


Рис. 2. Прямые ветви ВАХ гетероструктуры в полулогарифмическом масштабе (3kT/e < V < 0.7 эВ). T, K: 1 — 318, 2 — 308, 3 — 293, 4 — 278

тока от напряжения. В области напряжения 3kT/e < V < 0.7 эВ наклон зависимости  $\ln I = f(V)$  не зависит от температуры, поэтому исключается возможность анализа переноса тока на основании генерационно-рекомбинационных процессов в области пространственного

заряда [10]. Постоянный наклон зависимости  $\ln I = f(V)$  при различных температурах свидетельствует о туннельном механизме переноса тока. Однако при малых напряжениях ширина переходной области еще толстая для туннелирования носителей. Хотя, из-за существования на границе раздела ГП p-Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>/n-Si достаточного количества дислокаций несоответствия можно считать, что основным механизмом переноса тока является туннельно-рекомбинационные процессы с участием поверхностных состояний. В этом случае зависимость тока от напряжения определяется следующим выражением [10]:

$$I = B_0 \exp\{-\alpha[\varphi_k(T) - eV]\},\qquad(2)$$

где  $B_0$  — величина, которая слабо зависит от температуры и напряжения,  $\phi_k$  — высота потенциального барьера.

Перепишем выражение (2)

$$I = B_0 \exp[-\alpha \varphi_k(T)] \exp(\alpha eV) = I_0 \exp(\alpha eV),$$
(3)

где  $I_0 = B_0 \exp[-\alpha \varphi_k(T)]$  — ток отсечки, который не зависит от напряжения. Как видно из выражения (3), наклон  $\Delta \ln I/\Delta V$  начальных участков BAX (рис. 2) определяет величину  $\alpha$ , которая равна 9,5 эВ<sup>-1</sup>.

Подставив формулу (1) в выражение тока отсечки, получим

$$I_0 = B_0 \exp\{-\alpha[\varphi_k(0) - \beta_{\varphi}T]\} =$$

$$= B_0 \exp[-\alpha\varphi_k(0)] \exp(\alpha\beta_{\varphi}T) = I_c \exp(\alpha\beta_{\varphi}T),$$

где  $I_{c}$  — константа.

На вставке к рис. 2. приведена зависимость  $\ln I_0 = f(T)$ , из наклона которой можно определить значение коэффициента  $\alpha$ :

$$\alpha = (\beta_{\infty})^{-1} (\Delta \ln I / \Delta T) = 9.8 \text{ } 9B^{-1}.$$
 (4)

Сравнительно близкие значения коэффициента  $\alpha$ , определенные из различных зависимостей, подтверждают достоверность анализа начальных участков BAX структур p-Cu<sub>2</sub>ZnSnS<sub>4</sub>/n-Si в рамках многоступенчатого туннельно-рекомбинационного механизма переноса тока с участием локальных состояний на границе раздела ГП.

В области напряжений V > 0.8 В зависимость  $\ln I = f(V)$  описывается формулой Ньюмена для туннельного тока [11]:

$$I \sim \exp(AV)\exp(BT),$$
 (5)

где A и B — константы, не зависящие от напряжения и температуры. Из рис. З видно, что наклон  $\Delta \ln I/\Delta V$  начальных участков прямых ветвей ВАХ определяет коэффициент A (5), который принимает значение A=1,9 В $^{-1}$ . Из наклона температурной зависимости туннельного тока определяли величину  $B=2,7\cdot 10^{-2}$  К $^{-1}$ .

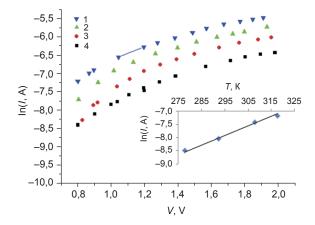


Рис. 3. Прямые ветви ВАХ ГП в полулогарифмическом масштабе (V > 0.8 В). T, K: 1 — 318, 2 — 308, 3 — 293, 4 — 278. На вставке — температурная зависимость тока отсечки

Рассмотрим механизм токопереноса через  $\Gamma\Pi \ p$ - $\mathrm{Cu_2ZnSnS_4}/n$ - $\mathrm{Si} \ при \ обратном смещении. На рис. 4 приведены зависимости <math>\ln I_{revt} = f(\varphi_k - eV)^{-1/2}$  для различных температур.

Величина туннельного тока резкого гетероперехода при обратном смещении выражается формулой [12]

$$I_{rev(t)} = a \exp[-b/(\varphi_k - eV)^{1/2}],$$
 (6)

где a и b — коэффициенты, не зависящие от напряжения. Как видно из рис. 4, зависимости  $\ln I_{revt} = f(\phi_k - eV)^{-1/2}$  состоят из линейных участков с определенным наклоном. Следовательно, можно предположить, что механизмом токопереноса в  $\Gamma\Pi$  p- $Cu_2$ ZnSnS $_4$ /n-Si при обратном смещении (3kT/e < |V| < 1,0 эВ) является туннелирование сквозь потенциальный барьер с участием глубокого энергетического уровня на металлургической границе  $\Gamma\Pi$  [10]. При более высоких обратных напряжениях наблюдается мягкий пробой.

Таким образом, исследованы электрические характеристики  $\Gamma\Pi \ p\text{-}\mathrm{Cu_2}\mathrm{ZnSnS_4}/n\text{-}\mathrm{Si}$ , полученных сульфиризацией базовых

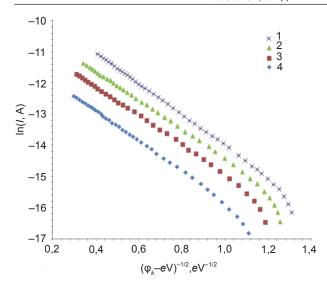


Рис. 4. Обратные ветви ВАХ ГП p-Cu $_2$ ZnSnS $_4$ /n-Si при T, K: 1 — 278 K, 2 — 293 K, 3 — 308 K, 4 — 318 K

металлических слоев. На основе анализа температурных зависимостей BAX ГП p-Cu $_2$ ZnSnS $_4$ /n-Si установлено, что при малых прямых напряжениях (3kT/e < V < 0.7 эВ) основным механизмом токопереноса является ступенчатые туннельно-рекомбинационные процессы с участием дефектных состояний на границе раздела. При напряжениях U > 0.8 В доминирует туннельный механизм Ньюмена.

В случае обратного смещения (3kT/e < |V| < 1,0 эВ) основным механизмом переноса носителей заряда через ГП является туннелирование сквозь потенциальный барьер с участием глубокого энергетического уровня. При более высоких обратных напряжениях наблюдается мягкий пробой.

#### ЛИТЕРАТУРА

- 1. Todorov T. K., Tang J., Bag S., Gunawan O., Gokmen T., Yu Zhu and Mitzi D. D. // Adv. Energy Mater. 2013. No. 3. P. 34–38.
- 2. Jiang M., Li Y., Dhakal R., Thapalia P., Mastro M., Caldwell J. D., Kub F., Yan X. J. // J. Photonics Energy. 2011. Vol. 1. P. 019501.
- 3. Wang W., Winkler M. T., Gunawan O., Gokmen T., Todorov T. K., Zhu Y., Mitzi D. B. // In: Advanced Energy Materials. 2013. DOI: 10.1002/aenm. P. 01465.
- 4. Opanasyuk A. S., Kurbatov D. I., Ivanchenko M. M., Protsenko I. Yu., Cheong H. // Photon Energy. 2012. Vol. 4, No. 1. P. 01024 (3 pp).

- Oleksyuk I. D., Dudchar I. V., Piskach L. V., Allys J. // Compounds. — 2004. — Vol. 368. — P. 135–143.
- Юсупов А., Адамбаев К., Джумабаев Д. К., // Материалы Межд. конференции «Фундаментальные и прикладные вопросы физики». — Ташкент. — 2013. — С. 282–283.
- 7. Юсупов А., Адамбаев К., Тураев 3. 3. // Гелиотехника. 2015. № 3. С. 52–55.
- Юсупов А., Адамбаев К., Тураев З. З., Кутлимратов А. ДАН РУз. 2016. № 1. С. 34–37.
- 9. Миллнс А., Фойхт Д. М.: «Мир», 1970. 285 с.
- 10. Шарма Б. Л., Пурохит Р. К. М.: «Сов. радио», 1979. 224 с.
- 11. Мостовой А. И., Брусь В. В., Марьянчук П. Д. // ФТП. 2014. Т. 48, № 9. С. 1205–1208.
- 12. Razykov T. M., Ferekideg C. S., Morel D., Stefanakos E., Ullal H. S., Upadhyaya H. M. // Solar Energy. 2011. Vol. 85. 1580 p.

#### **LITERATURA**

- 1. Todorov T. K., Tang J., Bag S., Gunawan O., Gokmen T., Yu Zhu and Mitzi D. D. // Adv. Energy Mater. 2013. No. 3. P. 34–38.
- Jiang M., Li Y., Dhakal R., Thapalia P., Mastro M., Caldwell J. D., Kub F., Yan X. J. // J. Photonics Energy. — 2011. — Vol. 1. — P. 019501.
- 3. Wang W., Winkler M. T., Gunawan O., Gokmen T., Todorov T. K., Zhu Y., Mitzi D. B. // In: Advanced Energy Materials. 2013. DOI: 10.1002/aenm. P. 01465.
- 4. Opanasyuk A. S., Kurbatov D. I., Ivanchenko M. M., Protsenko I. Yu., Cheong H. // Photon Energy. 2012. Vol. 4, No. 1. P. 01024 (3 pp).
- Oleksyuk I. D., Dudchar I. V., Piskach L. V., Allys J. // Compounds. — 2004. — Vol. 368. — P. 135–143.
- 6. Yusupov A., Adambaev K., Dzhumabaev D. K. // Materialy Mezhd. konferencii «Fundamental'nye i prikladnye voprosy fiziki». Tashkent. 2013. P. 282–283.
- 7. Yusupov A., Adambaev K., Turaev Z. Z. // Geliotehnika. 2015. No. 3. P. 52–55.
- 8. Yusupov A., Adambaev K., Turaev Z. Z., Kutlimratov A. DAN RUz. 2016. No. 1. P. 34–37.

- 9. Millns A., Fojht D. M.: «Mir», 1970. 285 p.
- 10. Sharma B. L., Purohit R. K. M.: «Sov. radio», 1979. 224 p.
- 11. Mostovoj A. I., Brus' V. V., Mar'yanchuk P. D. // FTP. 2014. Vol. 48, No. 9. P. 1205–1208.
- 12. Razykov T. M., Ferekideg C. S., Morel D., Stefanakos E., Ullal H. S., Upadhyaya H. M. // Solar Energy. 2011. Vol. 85. P. 1580.